

Appel d'offres
VILLE DE MONTRÉAL

**Direction générale adjointe – Services institutionnels Service de
l'approvisionnement**

Des soumissions sont demandées et devront être reçues, avant 13 h 30 à la date ci-dessous, au Service du greffe de la Ville de Montréal – Édifice Lucien-Saulnier, à l'attention du greffier, 155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5 pour :

Catégorie : Biens et services généraux

Appel d'offres : 21-18740

Descriptif : Acquisition et fourniture de service de découpe laser et plasma de pièces métalliques

Date d'ouverture : 11 mai 2021

Dépôt de garantie : Aucun

Renseignements : Badre Eddine sakhi, Agent d'approvisionnement II
Courriel : badre.sakhi@montreal.ca

Visite obligatoire : Non

Documents : Les documents relatifs à cet appel d'offres seront disponibles à compter du le 07 avril 2021

Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de soumission en s'adressant au Service électronique d'appels d'offres (SÉAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO.

Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe cachetée et portant l'identification fournie en annexe du document d'appel d'offres.

Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement dans les locaux du Service du greffe à l'Hôtel de ville, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour leur réception.

La Ville de Montréal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et n'assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.

Fait à Montréal, le 07 avril 2021

Le greffier de la Ville,

Yves Saindon, avocat

Journaux de publication : Le Journal de Montréal Autre à préciser* : _____

Système à deux enveloppes : oui ___ non

Autre information utile aux fins du traitement des soumissions ? Aucune

*Toute publication additionnelle est aux frais du requérant, Version avril 2019